

2023-2029年中国集成电路 封装行业分析与发展前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国集成电路封装行业分析与发展前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202307/385541.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2023-2029年中国集成电路封装行业分析与发展前景预测报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

第1章：中国集成电路封装行业“专精特新”发展概述

1.1 集成电路封装行业的界定

1.1.1 集成电路封装的界定

1.1.2 集成电路封装所处产业链环节

1.1.3 集成电路封装行业分类

1.1.4 集成电路封装所属国民经济行业分类

1.2 “专精特新”概念界定

1.2.1 “专精特新”概念解读

1.2.2 “专精特新”相关概念辨析

（1）专精特新“小巨人”

（2）专精特新中小企业

（3）其他相关概念辨析

1.3 “专精特新”发展背景及发展地位分析

1.3.1 “专精特新”发展背景-内因分析

（1）中国中小企业发展现状

（2）中国制造业发展现状

（3）服务“国内国际双循环”发展格局

1.3.2 “专精特新”发展背景-外因分析

（1）全球贸易摩擦加剧、外部环境动荡

（2）中国高科技发展遭遇“卡脖子”

1.3.3 “专精特新”发展地位分析

1.4 本报告研究范围界定说明

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

第2章：全球及中国集成电路封装行业发展现状分析

2.1 全球集成电路封装行业发展现状

2.1.1 全球集成电路封装行业发展规模

2.1.2 全球集成电路封装行业区域发展格局

2.1.3 全球集成电路封装行业企业竞争格局

2.2 中国集成电路封装行业发展现状

2.2.1 中国集成电路封装行业发展规模

2.2.2 中国集成电路封装行业区域发展格局

2.2.3 中国集成电路封装行业企业竞争格局

2.3 中国集成电路封装行业技术水平及国产化现状

2.3.1 中国集成电路封装行业技术发展现状

(1) 集成电路封装行业技术创新现状

(2) 集成电路封装行业专利申请情况

(3) 集成电路封装行业技术研发趋势

2.3.2 中国集成电路封装行业国产化发展现状

(1) 集成电路封装行业国产化率分析

(2) 集成电路封装行业本土企业布局

2.4 中国集成电路封装行业发展机遇与挑战分析

第3章：中国集成电路封装行业“专精特新”政策环境及投融资环境分析

3.1 中国集成电路封装行业“专精特新”政策环境分析

3.1.1 国家层面集成电路封装行业发展相关政策及规划汇总解读

(1) 集成电路封装行业发展相关政策汇总

(2) 集成电路封装行业发展相关规划汇总

3.1.2 国家层面集成电路封装行业“专精特新”相关政策汇总解读

3.1.3 国家“十四五”规划对集成电路封装行业发展的影响分析

3.1.4 “国内国际双循环”战略的提出对集成电路封装行业的影响分析

3.1.5 集成电路封装行业“专精特新”发展的政策机遇分析

3.2 中国集成电路封装行业“专精特新”投融资环境分析

3.2.1 中国集成电路封装行业“专精特新”领域主要资金来源

3.2.2 中国集成电路封装行业“专精特新”领域投融资主体

- 3.2.3 中国集成电路封装行业“专精特新”领域投融资方式
- 3.2.4 中国集成电路封装行业“专精特新”领域投融资事件汇总
- 3.2.5 中国集成电路封装行业“专精特新”领域投融资机遇分析
 - (1) 集成电路封装行业“专精特新”财税扶持力度
 - (2) 集成电路封装行业“专精特新”信贷支持政策
 - (3) 集成电路封装行业“专精特新”市场化融资渠道
 - (4) 北京交易所成立带来的发展机遇分析
- 3.3 中国集成电路封装行业“专精特新”发展战略支撑及保障

第4章：中国集成电路封装行业“专精特新”企业培育方案及培育现状解读

- 4.1 中国集成电路封装行业“专精特新”企业培育方案解读
 - 4.1.1 集成电路封装行业国家级“专精特新”企业培育目的
 - 4.1.2 集成电路封装行业国家级“专精特新”企业培育对象
 - 4.1.3 集成电路封装行业国家级“专精特新”企业培育内容
 - 4.1.4 集成电路封装行业国家级“专精特新”企业培育措施
 - 4.1.5 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业奖励标准
- 4.2 中国集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报条件及流程解读
 - 4.2.1 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报-基本条件
 - 4.2.2 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报-专项条件
 - 4.2.3 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报-分类条件
 - 4.2.4 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报流程解读
- 4.3 中国集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业培育现状分析
 - 4.3.1 全国专精特新“小巨人”企业培育现状
 - (1) 专精特新“小巨人”企业培育进展
 - (2) 专精特新“小巨人”企业培育特征
 - (3) 专精特新“小巨人”企业行业分布
 - 4.3.2 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业培育现状
 - (1) 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业培育进展
 - (2) 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业培育特征

第5章：中国集成电路封装产业链全景梳理及“专精特新”鼓励布局方向

- 5.1 中国集成电路封装产业结构属性（产业链）分析

- 5.1.1 中国集成电路封装产业链结构梳理
- 5.1.2 中国集成电路封装产业链生态图谱
- 5.2 中国集成电路封装产业价值属性（价值链）分析
 - 5.2.1 中国集成电路封装行业成本结构分析
 - 5.2.2 中国集成电路封装行业价值链分析
- 5.3 中国集成电路封装行业发展痛点分析
- 5.4 中国集成电路封装产业链“专精特新”鼓励布局方向

第6章：中国集成电路封装产业链环节“专精特新”布局状况研究

- 6.1 中国集成电路封装行业之先进封装材料“专精特新”布局状况研究
 - 6.1.1 中国集成电路封装行业之先进封装材料发展现状分析
 - (1) 先进封装材料市场发展规模
 - (2) 先进封装材料技术发展现状
 - (3) 先进封装材料国产化发展现状
 - 6.1.2 中国集成电路封装行业之先进封装材料发展痛点分析
 - 6.1.3 中国集成电路封装行业之先进封装材料“专精特新”市场培育现状
 - 6.1.4 中国集成电路封装行业之先进封装材料市场竞争格局分析
 - 6.1.5 中国集成电路封装行业之先进封装材料发展前景及趋势分析
- 6.2 中国集成电路封装行业之封测设备“专精特新”布局状况研究
 - 6.2.1 中国集成电路封装行业之封测设备发展现状分析
 - (1) 封测设备市场发展规模
 - (2) 封测设备技术发展现状
 - (3) 封测设备国产化发展现状
 - 6.2.2 中国集成电路封装行业之封测设备发展痛点分析
 - 6.2.3 中国集成电路封装行业之封测设备“专精特新”市场培育现状
 - 6.2.4 中国集成电路封装行业之封测设备市场竞争格局分析
 - 6.2.5 中国集成电路封装行业之封测设备发展前景及趋势分析
- 6.3 中国集成电路封装行业之SIP封装“专精特新”布局状况研究
 - 6.3.1 中国集成电路封装行业之SIP封装发展现状分析
 - (1) SIP封装市场发展规模
 - (2) SIP封装技术发展现状
 - (3) SIP封装国产化发展现状

6.3.2 中国集成电路封装行业之SIP封装发展痛点分析

6.3.3 中国集成电路封装行业之SIP封装“专精特新”市场培育现状

6.3.4 中国集成电路封装行业之SIP封装市场竞争格局分析

6.3.5 中国集成电路封装行业之SIP封装发展前景及趋势分析

6.4 中国集成电路封装行业之WLCSP封装“专精特新”布局状况研究

6.4.1 中国集成电路封装行业之WLCSP封装发展现状分析

(1) WLCSP封装市场发展规模

(2) WLCSP封装技术发展现状

(3) WLCSP封装国产化发展现状

6.4.2 中国集成电路封装行业之WLCSP封装发展痛点分析

6.4.3 中国集成电路封装行业之WLCSP封装“专精特新”市场培育现状

6.4.4 中国集成电路封装行业之WLCSP封装市场竞争格局分析

6.4.5 中国集成电路封装行业之WLCSP封装发展前景及趋势分析

第7章：中国集成电路封装行业区域发展格局及“专精特新”发展研究

7.1 中国集成电路封装产业资源区域分布状况

7.2 中国集成电路封装行业企业数量区域分布

7.3 中国集成电路封装行业区域发展格局分析

7.4 中国各省市集成电路封装行业“专精特新”政策环境分析

7.5 中国各省市集成电路封装行业“专精特新”企业培育方案及申报条件

7.5.1 集成电路封装行业省市级“专精特新”企业培育方案解读

(1) 省级“专精特新”企业培育方案解读

(2) 市级“专精特新”企业培育方案解读

7.5.2 集成电路封装行业省市级“专精特新”企业奖励标准

7.5.3 集成电路封装行业省市级“专精特新”企业申报条件解读

(1) 省级“专精特新”企业申报条件

(2) 市级“专精特新”企业申报条件

7.5.4 集成电路封装行业省市级“专精特新”企业申报流程解读

(1) 省级“专精特新”企业申报流程

(2) 市级“专精特新”企业申报流程

7.6 中国各省市集成电路封装行业“专精特新”市场培育现状

7.6.1 各省市集成电路封装行业“专精特新”企业培育规模

7.6.2 各省市集成电路封装行业“专精特新”市场培育格局

7.6.3 各省市集成电路封装行业“专精特新”市场培育特征

第8章：中国集成电路封装行业代表性“小巨人”企业布局对比及案例研究

8.1 中国集成电路封装行业代表性“小巨人”企业布局对比

8.2 中国集成电路封装行业代表性“小巨人”企业布局案例研究

8.2.1 企业一

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.2 企业二

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.3 企业三

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.4 企业四

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况

- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.5 企业五

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.6 企业六

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.7 企业七

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.8 企业八

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.9 企业九

- (1) 企业发展历程及基本信息

- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.10 企业十

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

第9章：中国集成电路封装行业“专精特新”发展趋势预判及前景预测

9.1 中国集成电路封装行业市场前景预测

9.2 中国集成电路封装行业“专精特新”发展趋势预判

9.3 中国集成电路封装行业“专精特新”发展前景预测

第10章：中国集成电路封装行业“专精特新”投资特性及投资机会分析

10.1 中国集成电路封装行业“专精特新”投资特性分析

10.1.1 中国集成电路封装行业“专精特新”投资壁垒分析

10.1.2 中国集成电路封装行业“专精特新”投资风险预警及防范

10.2 中国集成电路封装行业“专精特新”投资价值评估

10.3 中国集成电路封装行业“专精特新”投资机会分析

10.3.1 产业链薄弱环节投资机会

10.3.2 区域市场投资机会

10.3.3 细分市场投资机会

10.4 中国集成电路封装行业“专精特新”潜在发展方向分析

第11章：中国集成电路封装行业“专精特新”投资策略及发展建议

11.1 中国集成电路封装行业“专精特新”投资策略

11.2 中国集成电路封装行业“专精特新”发展建议

图表目录

图表1：中国集成电路封装行业本土企业布局情况

图表2：中国集成电路封装行业发展机遇与挑战分析

图表3：截至2021年中国集成电路封装行业发展政策汇总-国家层面

图表4：截至2021年中国集成电路封装行业发展规划汇总-国家层面

图表5：截至2021年中国集成电路封装行业“专精特新”发展政策解读-国家层面

图表6：中国集成电路封装行业发展痛点分析

图表7：中国集成电路封装行业先进封装材料本土企业布局情况

图表8：中国集成电路封装行业先进封装材料市场发展痛点分析

图表9：中国集成电路封装行业之封测设备本土企业布局情况

图表10：中国集成电路封装行业之封测设备发展痛点分析

图表11：中国集成电路封装行业之SIP封装本土企业布局情况

图表12：中国集成电路封装行业之SIP封装发展痛点分析

图表13：中国集成电路封装行业之WLCSP封装本土企业布局情况

图表14：中国集成电路封装行业之WLCSP封装发展痛点分析

图表15：企业一发展历程

图表16：企业一基本信息表

图表17：企业一股权穿透图

图表18：企业一经营状况

图表19：企业一整体业务架构

图表20：企业一销售网络布局

图表21：企业一集成电路封装业务布局优劣势分析

图表22：企业二发展历程

图表23：企业二基本信息表

图表24：企业二股权穿透图

图表25：企业二经营状况

图表26：企业二整体业务架构

图表27：企业二销售网络布局

图表28：企业二集成电路封装业务布局优劣势分析

图表29：企业三发展历程

图表30：企业三基本信息表

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202307/385541.html>